

圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，决定对募投项目进行延期。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】647号文”核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值1元，发行价格每股人民币29.82元，募集资金总额为人民币44,730.00万元，扣除各项发行费用4,029.45万元后，公司实际募集资金净额为人民币40,700.55万元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月26日出具的“致同验字（2017）第110ZC0185号”《验资报告》验证确认。

公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规的要求，公司制定了《圣邦微电子（北京）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》并结合经营需要，公司与保荐机构中信证券股份有限公司

(以下简称“中信证券”)、招商银行股份有限公司北京西三环支行、平安银行股份有限公司北京亦庄支行(以下统称“开户银行”)于2017年6月7日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

(三) 募集资金投资项目基本情况及使用情况

截至2019年9月30日,募投资金使用情况如下:

单位:万元

投资项目名称	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
电源管理类模拟芯片开发及产业化项目	否	16,398.17	16,398.17	12,617.00	76.94%	2019年12月31日	否
信号链类模拟芯片开发及产业化项目	否	16,870.20	16,870.20	7,860.37	46.59%	2019年12月31日	否
研发中心建设项目	否	7,432.18	7,432.18	2,478.96	33.35%	2019年12月31日	否
投资项目合计	--	40,700.55	40,700.55	22,956.33	56.40%	--	--

二、募集资金投资项目延期的有关情况其原因

(一) 本次延期的募集资金投资项目的实际建设情况

募集资金投资的三个项目是公司依据未来发展规划做出的战略性安排。其中,电源管理类模拟芯片开发及产业化项目主要集中研究和开发电源管理类系列芯片;信号链类模拟芯片开发及产业化项目主要集中研究和开发信号链类系列芯片;研发中心建设项目在公司现有技术研究中心基础上,扩大公司研发规模并进行技术升级,提高公司产品的研发效率、缩短产品研发、制造周期,提升公司核心竞争力。

三个项目实施以来,公司根据总体战略布局,结合市场的发展趋势,不断加强公司的技术研发和技术创新能力,持续进行核心技术的研发,每年按计划顺利推进各项新产品的研发。其中,信号链类模拟芯片开发及产业化项目包括高性能运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换及接口电路等;电源管理类模拟芯片开发及产业化项目包括LED驱动芯片、LDO、DC/DC转换器、锂电池充放电管

理及保护芯片等多系列产品。研发中心建设项目的3个技术实验室（模拟芯片设计技术实验室、模拟芯片专用EDA技术实验室、模拟芯片质量和可靠性技术实验室）进展顺利，截至2019年6月30日，公司累计已获得授权专利54项（其中36项为发明专利），已登记的集成电路布图设计登记证书83项。

随着物联网、可穿戴式设备、智能家居、新能源等新兴市场的快速发展，各类智能设备对芯片性能的要求也在不断提高。公司根据相关市场需求的变化趋势，基于公司芯片产品在高性能、低功耗、小尺寸、高可靠性等方面的技术积累和优势进行了相关新产品的规划，展开了相应的研发工作，特别是针对智能终端显示屏背光LED驱动、高效低功耗DC/DC电源转换、低噪声大电流小尺寸LDO等产品方向推出了一批达到世界先进水平的新型模拟芯片产品，如应用于智能手机、PAD的支持串并联的高压LED背光驱动芯片、输出电流可达500mA的低压差（150mV）线性稳压器等。另外，在制造工艺方面，公司新一代产品已完成了向0.18um制程的高压BCD工艺平台的过渡，这一工艺平台将有助于进一步降低芯片功耗、减小芯片面积，更适用于新一代消费类电子产品、物联网、移动智能终端等领域。在封装工艺方面，除了传统的SOT、DFN、QFN封装工艺外，越来越多的产品采用WLCSP封装以减小体积、提升性能，更加适用于便携式的智能移动终端产品。

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

根据市场情况变化，结合公司战略规划、实际经营情况及未来发展，为保证募投项目建设符合公司利益和需求，并结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、投资总额和投资内容不发生变更的情况下，拟将“电源管理类模拟芯片开发及产业化项目”、“信号链类模拟芯片开发及产业化项目”、“研发中心建设项目”等募投项目实施期限延期至2021年12月31日。

（三）本次募集资金投资项目延期的具体情况

投资项目名称	原计划项目达到预计可使用状态日期	本次调整后项目达到预计可使用状态日期
电源管理类模拟芯片开发及产业化项目	2019年12月31日	2021年12月31日
信号链类模拟芯片开发及产业化项目	2019年12月31日	2021年12月31日
研发中心建设项目	2019年12月31日	2021年12月31日

三、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目实施进度调整是公司根据实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额、投资内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

四、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为，本次对募集资金投资项目进度的调整是公司根据具体项目进展情况及投资计划做出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，未改变募集资金投资项目的内容、投资总额和实施主体，不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意公司《关于募集资金投资项目延期的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为，本次调整募集资金项目延期事项，是根据公司实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额、投资内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意公司《关于募集资金投资项目延期的议案》。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次事项履行了必要的审议程序和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。本次募集资金投资项目实施进度调整是公司根据实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额、投资内容和实施主体，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公

司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于圣邦微电子（北京）股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2019年12月20日